

## 開示の要約

### 研磨方法および研磨装置

- 5 ウェーハなどの基板の研磨を、予め設定された研磨時間で終了させることができる研磨方法が開示される。研磨方法は、研磨パッドの研磨面の温度を熱交換器で調整しながら、基板を研磨面に押し付けて基板を研磨し、基板の研磨開始から、基板の膜厚が目標厚さに到達するまでの実研磨時間が、目標研磨時間に一致するために必要な目標研磨レートを算定し、目標研磨レートを達成することができる研磨面の
- 10 目標温度を決定し、基板の研磨中に、熱交換器により研磨面の温度を目標温度に変更する工程を含む。

図 1